

Title (en)

Method for producing and enclosing of miniture and micro fuses.

Title (de)

Verfahren zum Herstellen und Verschliessen von Klein- und Kleinstsicherungen.

Title (fr)

Méthode pour produire et envelopper des minifusibles et microfusibles.

Publication

EP 0392398 A2 19901017 (DE)

Application

EP 90106691 A 19900406

Priority

DE 3912063 A 19890413

Abstract (en)

The invention relates to a method for enclosing an electrical component, especially a fuse, in which the housing parts (which were previously aligned loosely with respect to one another and were jointed to one another) are pressed onto one another under pressure during extrusion-coating. In this case, extrusion-coating takes place either only of the joint (or joints) or of the complete housing parts, with the exception of those surfaces on which the housing parts have been pressed together by plates or pins. <IMAGE>

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verschließen eines elektrischen Bauteils (1), insbesondere einer Sicherung, bei der die vorher lose zueinander ausgerichteten und aneinander gefügten Gehäuseteile (3,4) beim Umspritzen unter Druck aneinander gepreßt werden. Dabei findet eine Umspritzung (8) entweder nur der Teilfuge bzw. der Teilfugen oder der gesamten Gehäuseteile mit Ausnahme derjenigen Flächen statt, an denen die Gehäuseteile durch Platten oder Stifte zusammengedrückt worden sind. <IMAGE>

IPC 1-7

H01H 69/02; **H01H 85/165**; **H05K 5/00**; **H05K 5/06**

IPC 8 full level

H01H 85/00 (2006.01); **H01H 69/02** (2006.01); **H01H 85/02** (2006.01); **H01H 85/143** (2006.01); **H01H 85/165** (2006.01); **H01H 85/17** (2006.01); **H01H 85/175** (2006.01); **H05K 5/00** (2006.01); **H05K 5/06** (2006.01)

CPC (source: EP)

H01H 69/02 (2013.01); **H01H 85/165** (2013.01); **H01H 85/003** (2013.01); **H01H 2085/0034** (2013.01)

Cited by

DE102005027681A1; FR2725304A1; NL1000560C2

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0392398 A2 19901017; **EP 0392398 A3 19920304**; **EP 0392398 B1 19930324**; AT E87394 T1 19930415; DE 3912063 A1 19901018; DE 59001060 D1 19930429; JP 2869811 B2 19990310; JP H02299118 A 19901211

DOCDB simple family (application)

EP 90106691 A 19900406; AT 90106691 T 19900406; DE 3912063 A 19890413; DE 59001060 T 19900406; JP 9746390 A 19900412